

2023年度VDEC CAD利用覚書

使用者（甲）：
提供者（乙）：東京大学大学院工学系研究科附属システムデザイン研究センター 基盤設計研究部門

乙が提供するEDA製品の取り扱いに関して、甲乙とも下記条項に合意の上本契約を締結するものとする。

第1条：乙は、甲に対し乙が提供するEDA製品の使用を以下の条件と伴に許諾する。

1. 本契約により、甲は甲が所属する組織のキャンパス内においてソフトウェアの使用権のみを得るものとする。
2. 甲は、本契約に基づき自己が負うのと同等の義務および責任を課すことで当該研究室所属員の使用を許諾できるものとする。
3. 甲は、ソフトウェア使用者リストを管理し、年度末に一覧を提出するものとする。
4. 甲は、ソフトウェアを甲における研究および教育目的のみに使用し、いかなる場合も営利目的に使用してはならない。
5. 甲は、乙の提供するソフトウェアを使用して作成した成果物を営利目的に使用する場合、必ず乙の承認を得るとともに関係EDAベンダと協議し、使用の可否に関しては乙及び関係EDAベンダからの指示に従うものとする。
6. 上記 5. に定めた事項については、本契約の終了または解除後も継続するものとする。
7. 甲は、乙の提供するソフトウェアを使用することにより発生した障害や、ソフトウェアの不正利用によるEDAベンダからの苦情に対して一切の責任を負うものとする。

第2条：契約期間は、2023年4月1日から2024年3月31日までとする。

第3条：甲が本契約の条項に違反したときは、乙はその履行を書面で催告するものとし、履行されないときはソフトウェアの使用権を解除できるものとする。

第4条：甲は乙からのライセンス貸与に対し以下の責務を負うものとする。

1. 甲は乙のライセンスを使用し学会等にて成果発表を行う際、甲は必ずその発表論文に本書指定の書式により謝辞を記載する。
2. 甲は乙のライセンスを使用し達成した研究の成果を一年毎に乙に報告するものとする。

第5条：甲または乙が正当な理由によりこの契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の2ヶ月前までに文書をもって通知するものとする。

第6条：甲・乙は、この契約により知り得た甲・乙の業務上の秘密または情報その他の権利（法的利益を含む。）を第三者に漏洩し、または譲渡し、もしくは他の目的に利用してはならない。

第7条：第6条に定めた事項については、本契約の終了または解除後も継続するものとする。

第8条：この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲・乙協議の上これを定めるものとする。

本契約の締結の証として本書2通を作成し、甲は署名の上、乙宛に一通を電子メール添付ファイルで送付するものとする。

甲：

乙： 東京大学大学院工学系研究科附属システムデザイン研究センター 基盤設計研究部門
部門長 池田誠

センターからのお願い

本センターは教育界のみなさまのご支援や文部科学省をはじめとする関係各位のご理解で発足し、半導体関係業界のご協力で運営を開始することができました。今後ともこの活動をもり立てていくために、みなさまの協力を得て広く内外に宣伝していきたいと考えています。

つきましては本センターの提供するEDA製品を使用して行った研究の成果を論文誌・学会などで発表される際には、末尾あるいは脚注等の適当な箇所に

1. Cadence 社製品使用の場合

「本研究は、東京大学VDEC活動を通して、日本ケイデンス・デザイン・システムズ社の協力で行われたものである。」

“This work was also supported through the activities of VDEC, The University of Tokyo, in collaboration with Cadence Design Systems.”

2. Synopsys 社製品使用の場合

「本研究は、東京大学VDEC活動を通して、日本シノプシス合同会社の協力で行われたものである。」

“This work was also supported through the activities of VDEC, The University of Tokyo, in collaboration with NIHON SYNOPSYS G.K.”

3. Siemens 社製品使用の場合

「本研究は、東京大学VDEC活動を通して、シーメンスEDAジャパン株式会社の協力で行われたものである。」

“This work was also supported through the activities of VDEC, The University of Tokyo, in collaboration with Siemens Electronic Design Automation Japan K.K..”

4. Keysight 社製品使用の場合

「本研究は、東京大学VDEC活動を通して、キーサイト・テクノロジー株式会社の協力で行われたものである。」

“This work was also supported through the activities of VDEC, The University of Tokyo, in collaboration with Keysight Technologies.”

5. Sharp 社製品使用の場合

「本研究は、東京大学VDEC活動を通して、シャープ株式会社の協力で行われたものである。」

“This work was also supported through the activities of VDEC, The University of Tokyo, in collaboration with Sharp Corporation.”

6. Silvaco 社製品使用の場合

「本研究は、東京大学VDEC活動を通して、株式会社シルバコ・ジャパンの協力で行われたものである。」

“This work was also supported through the activities of VDEC, The University of Tokyo, in collaboration with Silvaco Japan Co., Ltd.”

7. 東芝社MeP 設計用製品使用の場合

「本研究は、東京大学VDEC活動を通して、株式会社東芝の協力で行われたものである。」

“This work was also supported through the activities of VDEC, The University of Tokyo, in collaboration with TOSHIBA Corporation.”

8. TOOL 社製品使用の場合

「本研究は、東京大学VDEC活動を通して、ツール株式会社の協力で行われたものである。」

“This work was also supported through the activities of VDEC, The University of Tokyo, in collaboration with TOOL Corporation.”

とご記載下さいますようお願い致します。

また、年度末に、d.lab/VDEC年報に掲載する研究成果報告として、d.lab/VDEC CADツールを利用した研究成果に関する簡単な発表論文リストの提出を依頼することになっておりますので、ご協力をお願い致します。